



2021年3月期第2四半期 決算説明

1. 当期連結決算においては、フェローテックは2020年4月～2020年9月末の業績を、それ以外の連結子会社・持分法適用会社は2020年1月～6月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2021年3月期第2四半期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は2020年11月25日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

連結決算サマリー

(百万円)	2020年3月期 2Q		2021年3月期 2Q		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	金額	増減率(%)
売上高	41,849	100.0	41,595	100.0	△ 254	△ 0.6%
売上原価	27,941	66.8	27,497	66.1	△ 444	△ 1.6%
売上総利益	13,908	33.2	14,099	33.9	191	1.4%
販売管理費	10,342	24.7	10,185	24.5	△ 157	△ 1.5%
営業利益	3,566	8.5	3,913	9.4	347	9.7%
営業外収益	786	1.9	1,053	2.5	267	34.0%
営業外費用	1,880	4.5	2,142	5.1	262	13.9%
経常利益	2,472	5.9	2,825	6.8	353	14.3%
特別利益	67	0.2	-	-	△ 67	△ 100%
特別損失	12	0.0	1,079	2.6	1,067	8,891.67%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,540	3.7	71	0.2	△ 1,469	△ 95.4%
設備投資額	19,123	-	10,136	-	△ 8,987	△ 47.0%
減価償却費	3,435	-	4,605	-	1,170	34.1%

注 為替レート2020/3月期→2021/3月期：米ドル 109.97円→108.24円 人民元 16.23円→ 15.32円（期中平均レート）

セグメント別売上高および営業利益

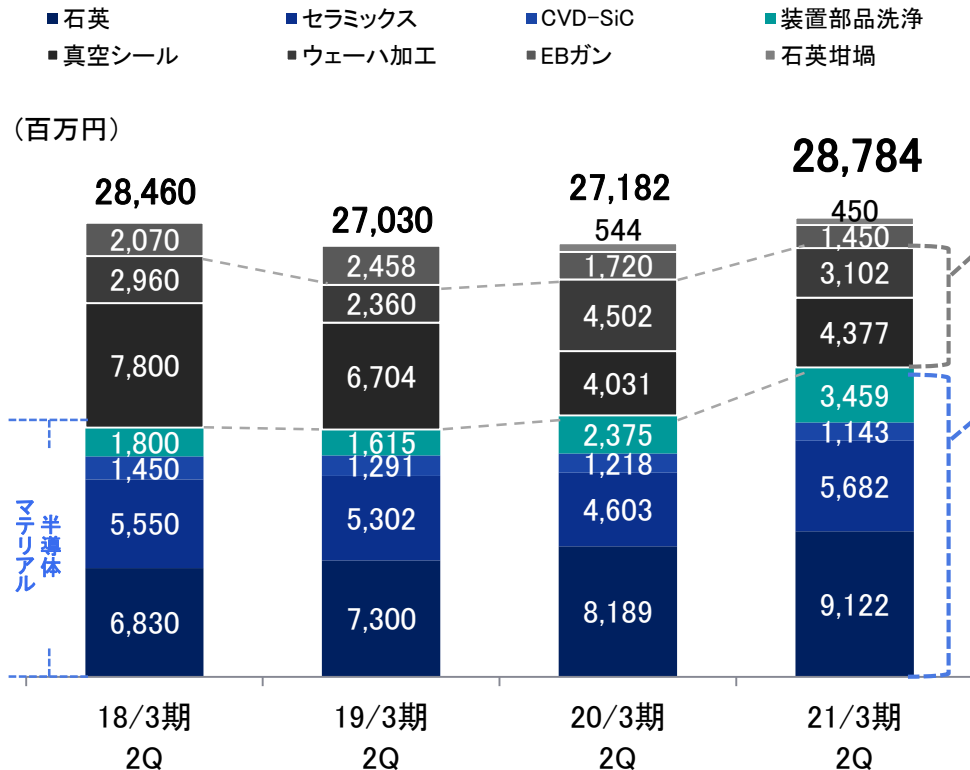
売上高 (単位:百万円)	2020年3月期 2Q		2021年3月期 2Q		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	27,182	65.0	28,784	69.2	1,602	5.9
電 子 デ バ イ ス	6,991	16.7	7,116	17.1	125	1.8
そ の 他	7,676	18.3	5,693	13.7	△ 1,982	△ 25.8
合 計	41,849	100.0	41,595	100.0	△ 254	△ 0.6

営業利益 (単位:百万円)	2020年3月期 2Q		2021年3月期 2Q		前期比	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	2,681	9.9	2,177	7.6	△ 504	△ 18.8
電 子 デ バ イ ス	1,320	18.9	1,868	26.2	548	41.5
そ の 他	191	2.5	345	6.1	154	80.6
全 社 消 去	△ 626	-	△ 477	-	149	-
合 計	3,566	8.5	3,913	9.4	347	9.7

※セグメント変更により19/3月期より太陽電池関連事業はその他事業に含めて計算しています

(百万円)		2020年3月期 2Q	2021年3月期 2Q	YoY 増減率
半	導 体 等 装 置 関 連	27,182	28,784	5.9
	真空シール	4,031	4,377	8.6
	石英製品	8,189	9,122	11.4
	セラミックス	4,603	5,682	23.4
	CVD-SiC	1,218	1,143	△ 6.2
	EBガン・LED蒸着装置	1,720	1,450	△ 15.7
	ウエーハ加工	4,502	3,102	△ 31.1
	装置部品洗浄	2,375	3,459	45.6
	石英坩堝(20/3期よりセグメント変更)	544	450	△ 17.3
電	子 デ バ イ ス	6,991	7,116	1.8
	サーモモジュール	6,651	6,814	2.5
	磁性流体・その他	340	302	△ 11.2
そ	の 他	7,676	5,693	△ 25.8
合	計	41,849	41,595	△ 0.6

売上高の推移



セグメント総括

- ・半導体材料、洗浄事業の売上は順調に拡大
- ・ウェーハ杭州新工場は顧客認定が進捗も、立上げ負担がセグメント収益に影響

真空シール、ウェーハ加工

- ・真空シール：半導体・有機EL製造装置の受注持直し、売上回復
- ・ウェーハ加工：8インチの本格的な需要回復なく、減収
杭州新工場の顧客認定進展も立上げ負担が増加

半導体材料、洗浄事業

【半導体材料(石英、セラミックス、CVD-SiC)】

- ・石英：半導体メーカー稼働率向上するなか、常山・東台工場の稼働が貢献し、石英の売上は順調に拡大基調、シリコンパーツも成膜・エッチング工程での需要が堅調
- ・セラミックス：成膜・エッチング装置部品の販売が順調に拡大、半導体検査治具材料の販売も増加
- ・CVD-SiC：欧州・米国向け落ち込むも、中国向けは好調

【洗浄事業】

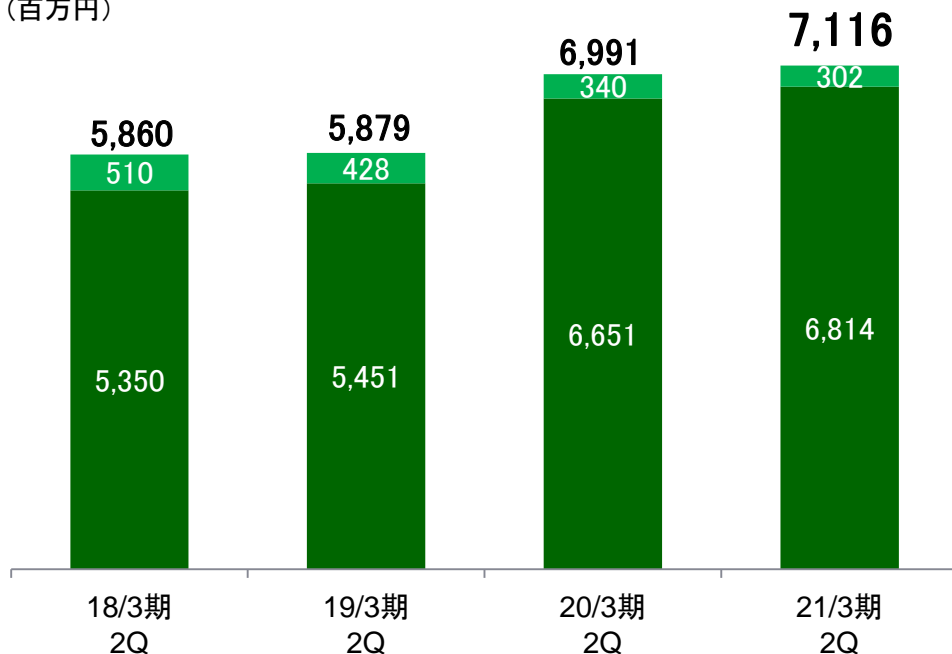
- ・中国半導体・FPD顧客の需要拡大、46%の大幅増収

※セグメント計上の変更により、19/3期、20/3期に石英坩堝を追加

売上高の推移

■ サーマモジュール ■ 磁性流体、他

(百万円)



セグメント総括

【サーモモジュール】

- ・中国を中心に5Gインフラ投資関連の通信機器向けが増大、ウェアラブル、IoT関連の需要も拡大
- 自動車温調シート向け売上減少するもセグメントの売上・利益は増加
- ・パワー半導体基板は、上期では産業機器向け等弱含み

連結貸借対照表 ～資産～

(百万円)	2020/3期 期末	2021/3期 9月末	増減額
流動資産	71,452	97,791	26,339
現金及び預金	23,709	34,881	11,172
受取手形及び売掛金	20,435	23,136	2,701
たな卸資産	17,269	19,128	1,859
固定資産	118,558	119,899	1,341
有形固定資産	110,817	112,214	1,397
建物及び構築物	27,346	26,252	△ 1,094
機械装置及び運搬具	30,113	27,430	△ 2,683
工具、器具及び備品	7,022	6,216	△ 806
土地	1,892	1,891	△ 1
リース資産(純額)	5,551	5,303	△ 248
建設仮勘定	38,894	45,123	6,229
無形固定資産	500	431	△ 69
のれん	26	-	-
投資その他資産	7,242	7,254	12
資産合計	190,010	217,690	27,680

【流動資産の主な増加要因】
 FTHD*保有の半導体ウエーハ子会社株式売却による増加
 ・現預金 : +11,355百万円
 ・未収入金**: +11,338百万円
 * フェローテックホールディングス単体
 **その他流動資産に計上

【有形固定資産の主な増加要因】
 ・建設仮勘定の増加は、ウエーハ事業及び再生ウエーハ事業における設備投資が主な要因
 ・建物及び構築物、機械装置及び運搬具の減少は、減価償却等によるもの

連結貸借対照表 ～負債及び純資産～

(百万円)	2020/3期 期末	2021/3期 9月末	増減額
流動負債	61,443	62,704	1,261
支払手形及び買掛金	18,252	17,091	△ 1,161
短期借入金	12,510	11,597	△ 913
1年内返済長期借入金 +1年内償還社債	13,507	15,911	2,404
固定負債	78,419	83,156	4,737
社債	19,282	17,998	△ 1,284
転換社債型新株予約権付社債	3,735	3,735	0
長期借入金	29,440	33,275	3,835
負債合計	139,862	145,861	5,999
純資産	50,148	71,830	21,682
株主資本	46,943	51,227	4,284
その他の包括利益累計額	1,453	1,142	△ 311
非支配株主持分	1,679	19,365	17,686
負債・純資産合計	190,010	217,690	27,680

【有利子負債の残高等】 ()内は20/3期末比
半導体ウエーハ子会社の長期借入金増加を主因に増加

短期借入+1年内長借・社債	27,508百万円	(+1,491)
長期借入+社債・転社	55,008百万円	(+2,551)
有利子負債 合計	82,515百万円	(+4,041)
[ネット有利子負債]	47,635百万円	(△ 7,130)

*大口ウエーハ補助金9,157百万円(+2,429)を長期前受収益(その他固定負債)に計上

【純資産の主な変動要因】
FTHD保有の半導体ウエーハ子会社株式売却による増加

資本剰余金	: +4,626百万円
非支配株主持分	: +16,926百万円
為替換算調整勘定	: +1,156百万円

注 為替レート2020/3期→2021/3期 : 米ドル 109.56円→ 107.74円 人民元 15.67円→ 15.23円(期末日レート)

キャッシュフロー計算書

(百万円)	2020/3期 2Q	2021/3期 2Q
営業活動によるキャッシュフロー	933	5,530
税引前当期純利益	2,527	1,745
減価償却費	3,435	4,605
減損損失	-	1,079
為替差損益(△:益)	405	715
売上債権の増減(△:増加)	936	△ 3,853
たな卸資産の増減(△:増加)	△ 2,131	△ 2,242
仕入債務の増減(△:減少)	△ 2,768	66
その他	△ 1,471	3,414
投資活動によるキャッシュフロー	△ 19,229	△ 9,967
有形固定資産取得による支出	△ 19,057	△ 10,108
有形固定資産の売却による収入	18	171
無形固定資産の取得による支出	△ 66	△ 28
その他	△ 124	△ 1
財務活動によるキャッシュフロー	14,909	15,875
短期借入金の増減額	2,757	1,682
長期借入れによる収入	6,637	9,488
長期借入金の返済による支出	△ 4,197	△ 5,615
社債の発行による収入	11,154	493
連結範囲変更を伴わない子会社株式の売却収入	-	11,354
その他	△ 1,442	△ 1,529
現金及び現金同等物の増加額	△ 3,591	11,172
現金及び現金同等物の期首残高	31,556	23,709
現金及び現金同等物の期末残高	28,087	34,881

【営業CFの状況】	
税引前利益+減価償却費:	6,351百万円
売上債権・棚卸資産・仕入債務の増減:	△ 6,029百万円

【投資CFの状況】	
有形・無形固定資産の取得:	△ 10,136百万円

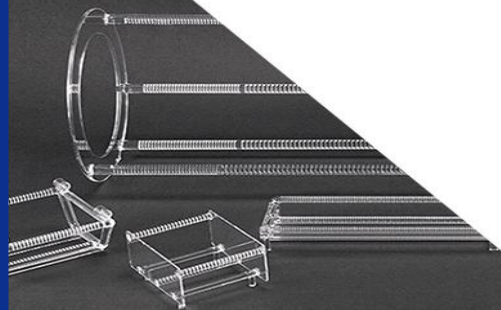
【財務CFの状況】	
長期借入及び社債による調達:	
・長期借り入れによる収入	9,488百万円
・社債の発行による収入	493百万円
合計	9,981百万円
子会社株式の売却:	11,354百万円



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



2021年3月期の業績予想について



- 通期業績予想は、8月14日公表値から変更なく、売上高850億円、営業利益65億円、当期利益15億円

(百万円)	2020/3期	2021/3期(計)	前期比(%)
売上高	81,614	85,000	4.1
営業利益	6,012	6,500	8.1
経常利益	4,263	5,500	29.0
親会社に帰属する 当期純利益	1,784	1,500	△ 16.0
減価償却費	7,600	10,000	31.6
EBITDA	13,613	16,500	21.2

注 為替レート2020/3月期→2021/3月期：米ドル 109.24円→108.24円 人民元 15.82円→ 15.32円(期中平均レート)

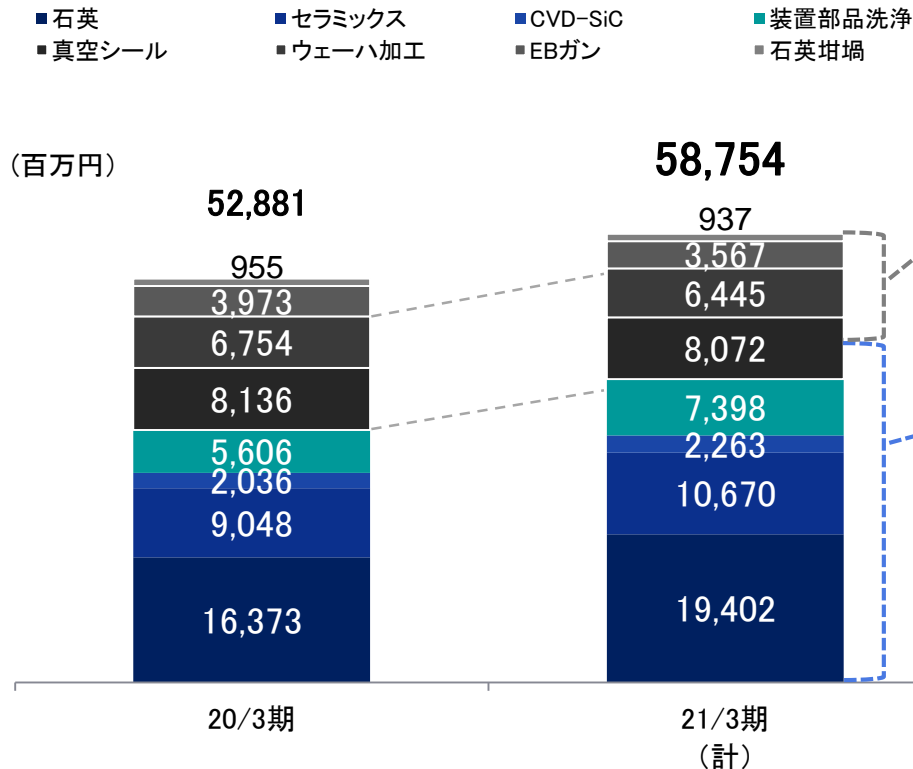
*EBITDA=営業利益+減価償却費にて計算

21/3期 通期製品別売上高詳細(前年比)

(百万円)820		2020/3月期	2021/3月期(計)	YoY 増減率
半 導 体 等 装 置 関 連		52,881	58,754	11.1
	真空シール	8,136	8,072	△ 0.8
	石英製品	16,373	19,402	18.5
	セラミックス	9,048	10,670	17.9
	CVD-SiC	2,036	2,263	11.1
	EBガン・LED蒸着装置	3,973	3,567	△ 10.2
	ウエーハ加工	6,754	6,445	△ 4.6
	装置部品洗浄	5,606	7,398	32.0
	石英坩堝(20/3期よりセグメント変更)	955	937	△ 1.9
電 子 デ バ イ ス		13,489	14,565	8.0
	サーモモジュール	12,701	13,795	8.6
	磁性流体・その他	789	770	△ 2.4
そ の 他		15,243	11,681	△ 23.4
合 計		81,614	85,000	4.1

注 為替レート2020/3月期→2021/3月期：米ドル 109.24円→108.24円 人民元 15.82円→ 15.32円(期中平均レート)

売上高の推移



セグメント総括

- ・半導体材料、洗浄事業の業績好調が持続
- ・ウエーハ杭州新工場立上げ負担が、引続きセグメント収益に影響

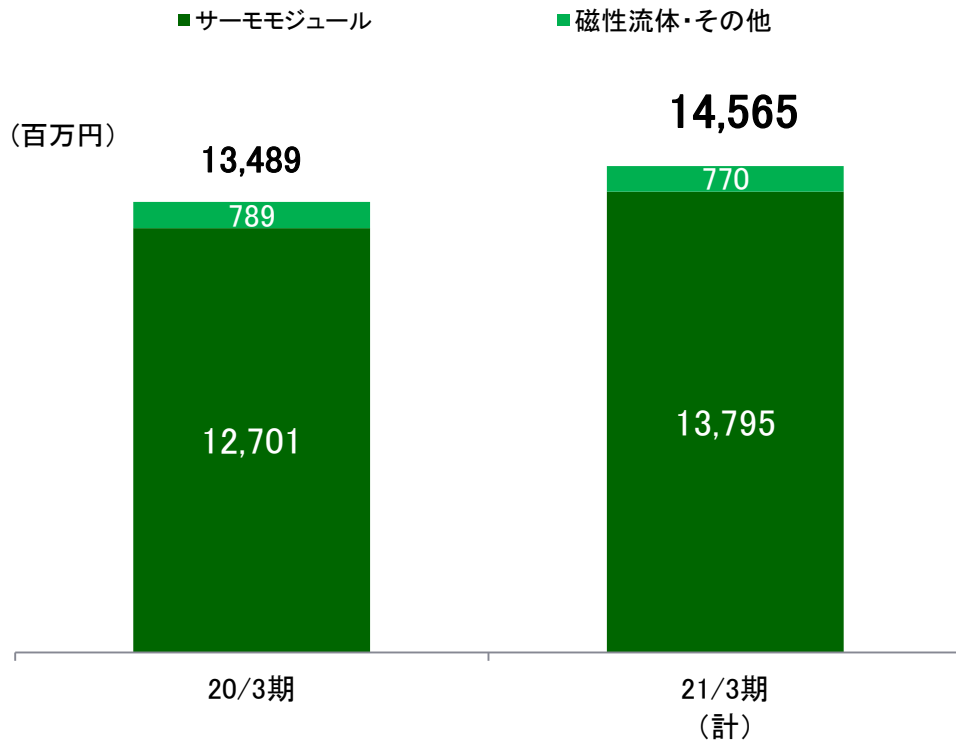
真空シール、ウェーハ加工

- ・真空シール：有機EL製造装置の服感、減収見込む
- ・ウェーハ加工：8インチは上半期横這い、12インチ増産目指す
杭州新工場の立上げ負担の継続を見込む

半導体材料、洗浄事業

- 【半導体材料(石英、セラミックス、CVD-SiC)】
- ・石英：半導体製造は堅調、治具消耗によるリピート需要により増収継続の見通し、設備増設も検討
シリコンパーツは、特にエッチング工程での需要が増加見通し
 - ・セラミックス：エッチング装置部品の好調な売上が継続
半導体検査治具材料は海外向けが堅調
 - ・CVD-SiC：中国向けが販売方法変更により一時的に減少
- 【洗浄事業】
- ・中国半導体メーカー等の稼働に連動、売上は堅調・拡大継続

売上高の推移



セグメント総括

【サーモモジュール】

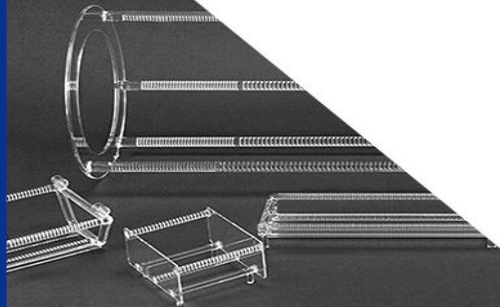
- ・自動車温調シート向けは回復の兆し、通信機器向けは上期並み・前年同期比増加
- ・パワー半導体基板は、上期比横這い



Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



第2四半期までにおける子会社の増資等 及び資金調達について



- 財務上の対応方針については、前回説明時(20年7月8日)から変更なし

20年7月8日説明会

【現状認識】

事業環境	半導体市場の拡大、とりわけ中国市場の発展を捉えた事業機会は豊富
当社の強み	半導体マテリアル製品、サーモ・モジュール、真空シール等、安定した事業基盤有する事業ポートフォリオ
当社の課題	大口径半導体ウエーハ等への積極投資による資産・有利子負債規模の拡大

【財務上の対応】 事業機会・投資機会と財務状況の適切なバランス確保に努める

投資・負債	設備投資・投資水準の管理、有利子負債水準の抑制・管理
資金調達	資金調達手法の多様化、資金調達の安定性の確保 中国におけるパートナー・資本活用の検討

- 事業機会と財務のバランス確保の観点から、ウエーハ子会社の一部譲渡、子会社増資を実施

【子会社増資等の実施概要及び財務影響(予定)】

円換算は@15.36

開示日	発表内容	財務状況への主な影響等(予定)
9/15	①半導体ウエーハ子会社(FTHW)株式の一部譲渡 譲渡価額 :19.7億元(約303億円) ➢ 内、FTHD保有分 :14.8億元(約227億円) ➢ 内、中国子会社保有分 : 4.9億元(約76億円)	➢ FTHD保有分譲渡は2Qに反映、純資産+227億円 ➢ 中国子会社(12月決算)保有分譲渡は3Qに反映予定 ➢ 増資後の出資比率は29.5%、持分法適用となる予定だが、未確定であり、精査中 ・連結の場合:B/S 非支配持分増、P/L 非支配損益プラス ・持分法の場合:B/S 連結範囲外、出資等内部取引計上 P/L 連結範囲外、持分投資損益マイナス
10/16	②半導体ウエーハ子会社の増資16.0億元(約246億円)	
10/16	③ウエーハ再生子会社の増資4.1億元(約63億円)	➢ 4Qに反映、最終出資比率41.3%・連結子会社となる予定 純資産(非支配株主持分)増加予定
10/16	④SiC(炭化ケイ素)会社設立、資本金8.9億元(約137億円)	➢ 当社出資は31.5%、2.8億元(43億円)
8/14	⑤洗浄事業子会社の上場準備、増資(1.6億元、約25億円)	➢ 当社出資67.0%、純資産(非支配株主持分)増加

- 従来計画の設備投資294億円及び資金調達260億円は実行予定
- 半導体ウエーハ子会社株式譲渡代金約303億円の内、約245億円を有利子負債返済に充当予定
- 子会社第三者割当増資計約334億円は、主に来期以降の投資資金に充当予定

【資金調達の従来計画及び追加実施】

従来計画の概要			
	項目	金額	資金用途等
	*7月8日決算説明時の資金調達内容	約260億円	1) 金融機関からの調達(95億円)、 2) 中国半導体ウエーハ子会社借入(95億円)、 3) 中国ウエーハ投資補助金(30億円)、 4) 中国再生ウエーハ事業会社増資(40億円)、以上の合計額
追加実施の概要			
	項目	金額	資金用途等
1	半導体ウエーハ子会社株式譲渡	約303億円	・有利子負債返済約245億円 ・SiC投資約43億円等
2	半導体ウエーハ子会社株式増資	約246億円	・設備投資資金(主に来期予定)
3	中国再生ウエーハ事業会社増資	約63億円	・設備投資資金(主に来期予定)
4	中国洗淨事業会社増資	約25億円	・設備投資資金(主に来期予定)

- ウエーハ子会社株式譲渡303億円・増資246億円により、有利子負債返済、財務バランス改善を見込む
- 半導体マテリアル製品等の需要旺盛、市場の成長を捉えた事業機会・投資機会は豊富
- 事業機会と財務の適切なバランス確保に留意し、更なる成長・企業価値向上を図る

主要指標 (億円)	2020/3月期	2021/3期2Q	追加の株式譲渡・増資の前期末比影響予想	
総資産	1,900	2,177	ウエーハ会社非連結時には、総資産減少要因	減少要因
有利子負債 (ネット有利子負債)	784 (547)	825 (476)	ウエーハ会社株式譲渡により約245億円返済 ウエーハ会社非連結時には、同社の借入連結外	減少要因
純資産 (内、非支配株主持分)	501 (17)	718 (194)	ウエーハ会社連結時には、非支配持分等増加 ウエーハ再生・洗浄増資約88億円による増加	増加要因
自己資本比率(非支配持分等控除*) 自己資本比率(分母:純資産)	25.5% 26.4%	24.1% 33.0%	ウエーハ会社非連結化時には、総資産減少 ウエーハ会社連結時には、非支配持分等増加	向上要因
D/E比率(分母:純資産)	1.56	1.13	有利子負債減少、純資産増加	向上要因
ROIC	3.1%	3.8%	ウエーハ会社非連結化時には、総資産減少	向上要因

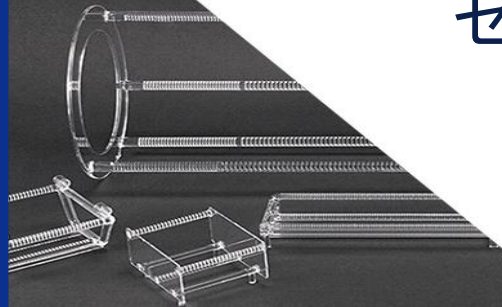
* 分母となる自己資本: 純資産-非支配株主持分-新株予約権



Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



2021年3月期第2四半期
セグメント別の状況と今後の見通し



69%

半導体等装置関連セグメント

真空シール



石英製品



セラミックス製品



CVD-SiC



装置洗浄



シリコンウエーハ



etc...

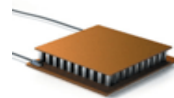
17%

電子デバイスセグメント

磁性流体



サーモモジュール



パワー半導体用基板



13%

その他

産業用刃物



受託組立



業務用洗濯機



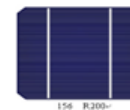
太陽電池(OEM)

PV用

ウエーハ



PV用セル

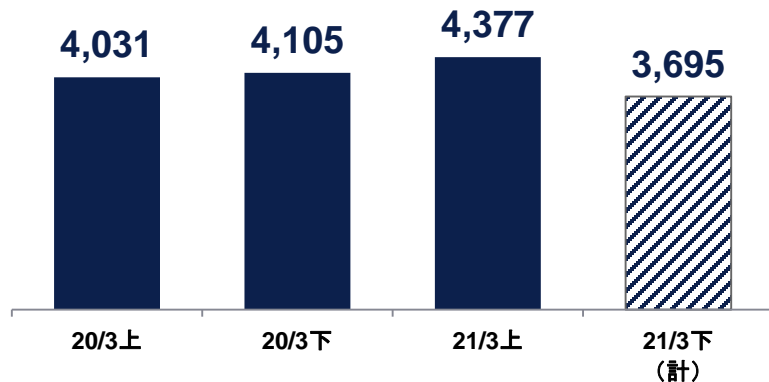


etc...

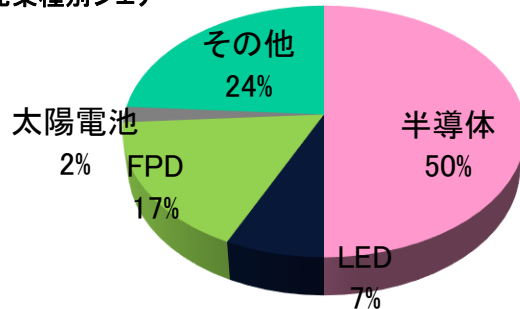
※ 円グラフは2021年3月期2Q時点の売上高に占める各セグメントの割合

売上高の推移

(百万円)



販売先業種別シェア



1. 21/3期 上期の業績

- 2019年後半以降、半導体、有機EL製造装置の受注が持ち直し、コロナ禍で顧客の導入タイミングに若干の遅延がみられたものの、上期は前年同期で増収
- 受託加工も半導体、その他分野で受注が持ち直し、堅調に推移

2. 21/3期 下期の見通し

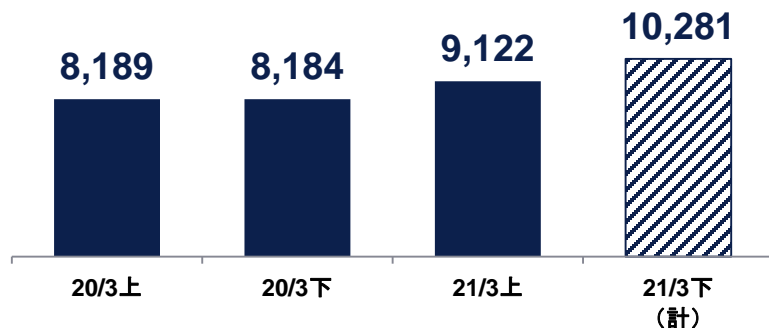
- 下期は、有機EL製造装置新規受注に一服感も出ていることから、上期比較で減収の見通し
- 受託加工については、上期より拡大見込み

《施策》

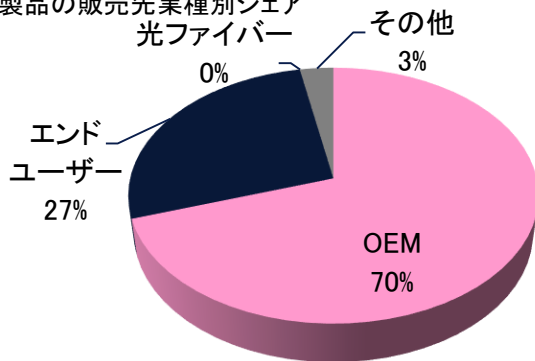
- 半導体製造装置メーカーとの共同開発を継続
- 大型加工機の設備投資継続
- 当社グループ間の関係を強化しシナジー獲得
- グループ各社の既存チャンネル・ブランドを活用し、中国市場での営業強化

売上高の推移

(百万円)



石英製品の販売先業種別シェア



1. 21/3期 上期の業績

- コロナ禍で一部設備導入遅延などがみられたものの、全世界的な5G、データセンター向けの旺盛な需要、および中国半導体市場の顕著な伸長もあり、ロジック系、メモリー系での新規投資、および半導体メーカーの稼働率向上から、石英製品の売上は増収
- Siパーツは、中国、台湾、日本市場を中心に、成膜工程、およびエッチ工程での需要が堅調に推移

2. 21/3期 下期の見通し

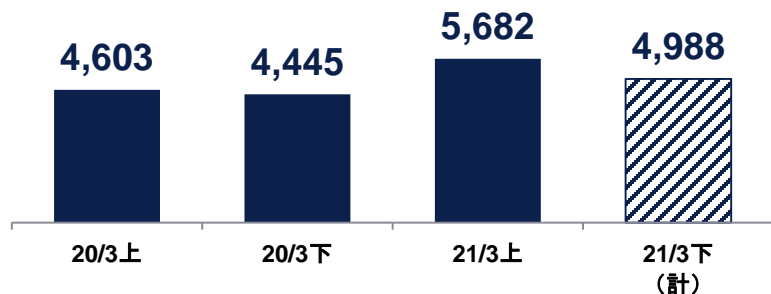
- ロジック系、およびNANDを中心とするメモリー系での新規設備投資需要は堅調に推移する見通し。また、治具消耗によるリピート需要の比率が高い石英は、下期も半導体メーカーの高稼働を背景に、上期比増収の見通し
- Siパーツは堅調、特にエッチ工程需要が増加見込み

《施策》

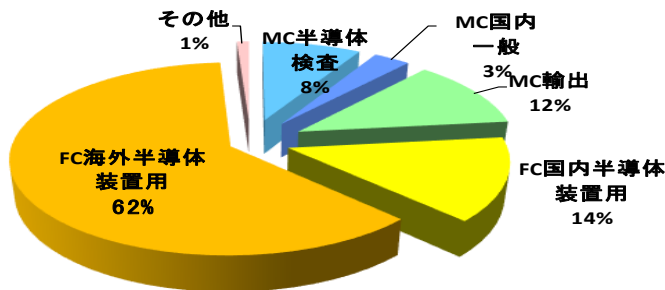
- 21年以降も大手OEM需要増が継続する為、更なる増産体制準備中（中国 東台工場での機械加工品向け設備増設と常山工場火加工工場の投資を検討）
- 国内 山形工場での次世代最先端装置向け製品の開発、試作対応（量産規模も小規模から、21年以降は中規模のステージへ移行）

売上高の推移

(百万円)



セラミックス製品の製品別販売シェア



注) FC: ファイン・セラミックス
MC: マシナブル・セラミックス(ホトベール)

1. 21/3期 (1-6月)の業績

<マシナブルセラミックス “ホトベール”>

- ・ 海外半導体検査治具材料の販売好調
- ・ 従来型、新型ともに半導体検査治具販売が堅調

<ファインセラミックス>

- ・ 海外成膜・エッチング装置部品の販売が大変好調
- ・ データ通信関連需要の増加により国内半導体装置各部品全体で好調

2. 21/3期 (7-12月)の見通し

<マシナブルセラミックス “ホトベール”>

- ・ 海外半導体検査治具材料の販売好調が継続
- ・ 国内半導体検査治具関係の後半は需要鈍化

<ファインセラミックス>

- ・ 海外エッチング装置部品好調継続
- ・ 国内半導体装置部品は上期在庫消化など鈍化

3. 継続販売方針

<マシナブルセラミックス>

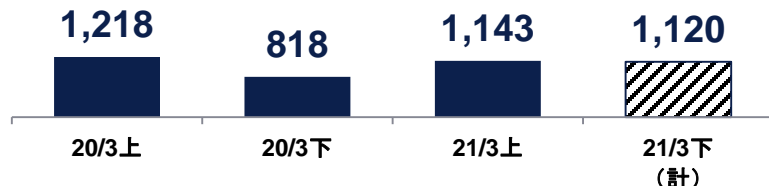
- ・ 微細化はさらに進行し、それに伴う新型検査治具の拡販に注力する
- ・ 高機能物性マシナブルセラミックス材料量産適用による拡販目指す
- ・ 医療、分析関係部品など新規分野への展開を図る

<ファインセラミックス>

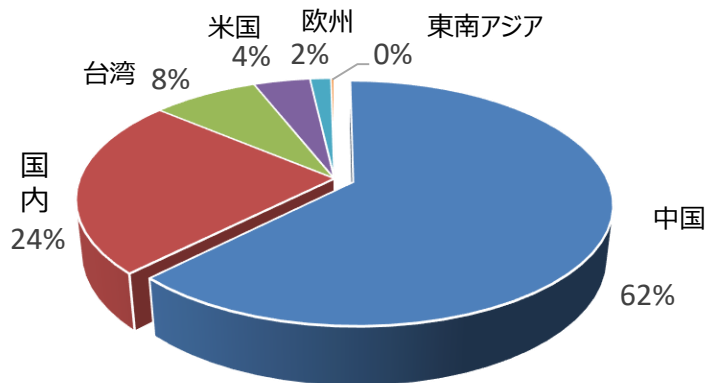
- ・ 誘電特性に優れたアルミナ材料の、新規半導体装置用部品への採用を目指す
- ・ 多種のセラミック材料で一般産業機械部品も拡販目指す

売上高の推移

(百万円)



CVD-SiC製品の地域別販売シェア



1. 21/3期(1-6月)の業績

- ・ 中国装置メーカー向け設備投資に関わる部材需要は好調に推移
- ・ 欧州・米国向け需要は落ち込む

2. 21/3期下期(7-12月)の見通し

- ・ 中国装置メーカー向け販売方法変更により一時的な売上減少
- ・ 半導体エッチャー装置向け消耗部材は 量産採用時期2021年1Qにシフト

《施策》

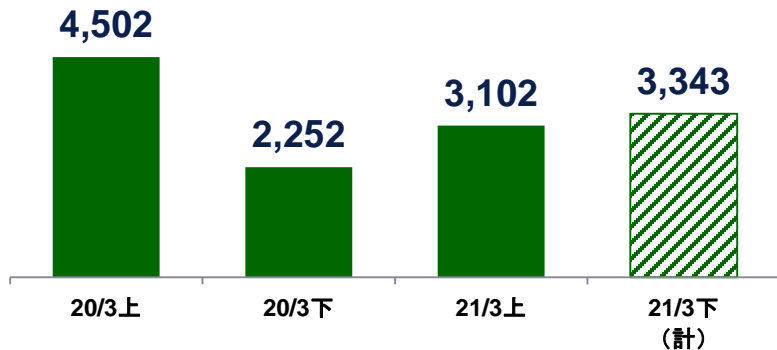
- ・ 半導体エッチャー装置向け消耗部材の拡販、生産体制の整備
- ・ SiC半導体に関わる開発・試作体制維持
- ・ 半導体製造装置メーカ、デバイスメーカーへの新規採用

ウェーハ加工と部品洗浄の状況と見通し

ウェーハ加工

売上高の推移

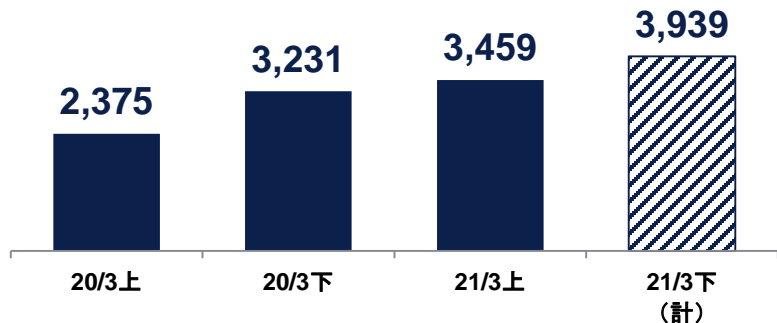
(百万円)



部品洗浄

売上高の推移

(百万円)



半導体ウェーハ:

1. 21/3期上期の業績

- 下期比で6インチは需要回復、8インチは本格的な需要回復が見られず、ウェーハ合計で前年同期比31.0%の減収となる

2. 21/3期下期の見通し

- 上期比6インチ伸長、8インチ横ばい。4Qから12インチ量産開始予定
《施策》
- 8インチは杭州新工場での新規顧客認定を強化中(本格増産は21年以降)
- 12インチ(月産3万枚)は、22/3期以降 更なる増産を検討。投資資金は、中国の政府・民間系複数ファンドからの第三者割当増資から充当

部品洗浄:

1. 21/3期上期の業績

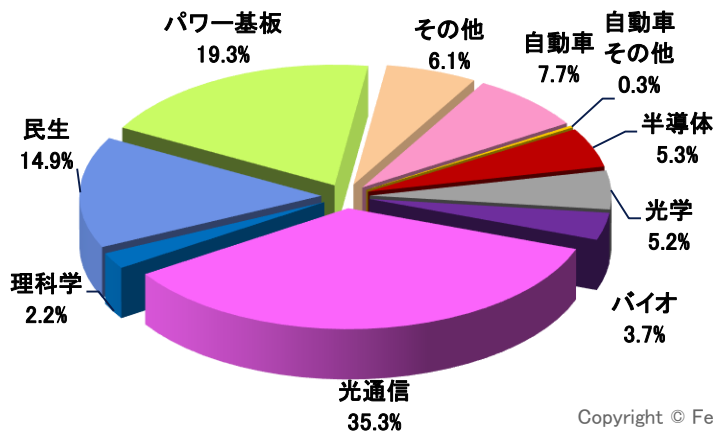
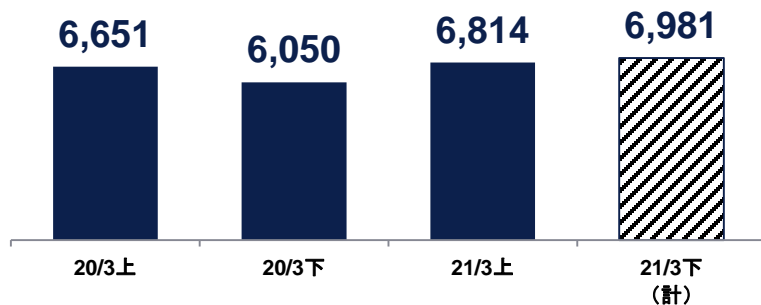
- 中国内の5拠点6工場での増産対応継続。中国半導体・FPD(有機EL/LCD)顧客需要伸長から、売上は前年同期比 45.6%の大幅増収へ

2. 21/3期下期の見通し

- 洗浄は、顧客の生産稼働に連動するストック型ビジネス。下期は中国市場でコロナ影響が限定的である見通しから、上期比11.5%増収見通し
《施策》
- 中国国産化に連動し、中長期での成長が見通せる環境から、安徽省の子会社への政府系ファンド出資も受け、今後上海科创板市場への上場準備を進める。投資資金は、中国での資本調達から充当

売上高の推移

(百万円)



1. 21/3期上期の業績

自動車向け

・コロナ影響で自動車販売台数減となり、温調シートは減収

その他の産業向け

- ・中国を中心に5Gインフラ投資に連動する通信機器用途は堅調
- ・民生はウェアラブル、IoT関連などの需要が拡大
- ・パワー基板は、車、産業機器向けが弱含み、前下期比で減収に

2. 21/3期下期の見通し

自動車向け

・下期の自動車向け温調シートは若干回復の兆し有り

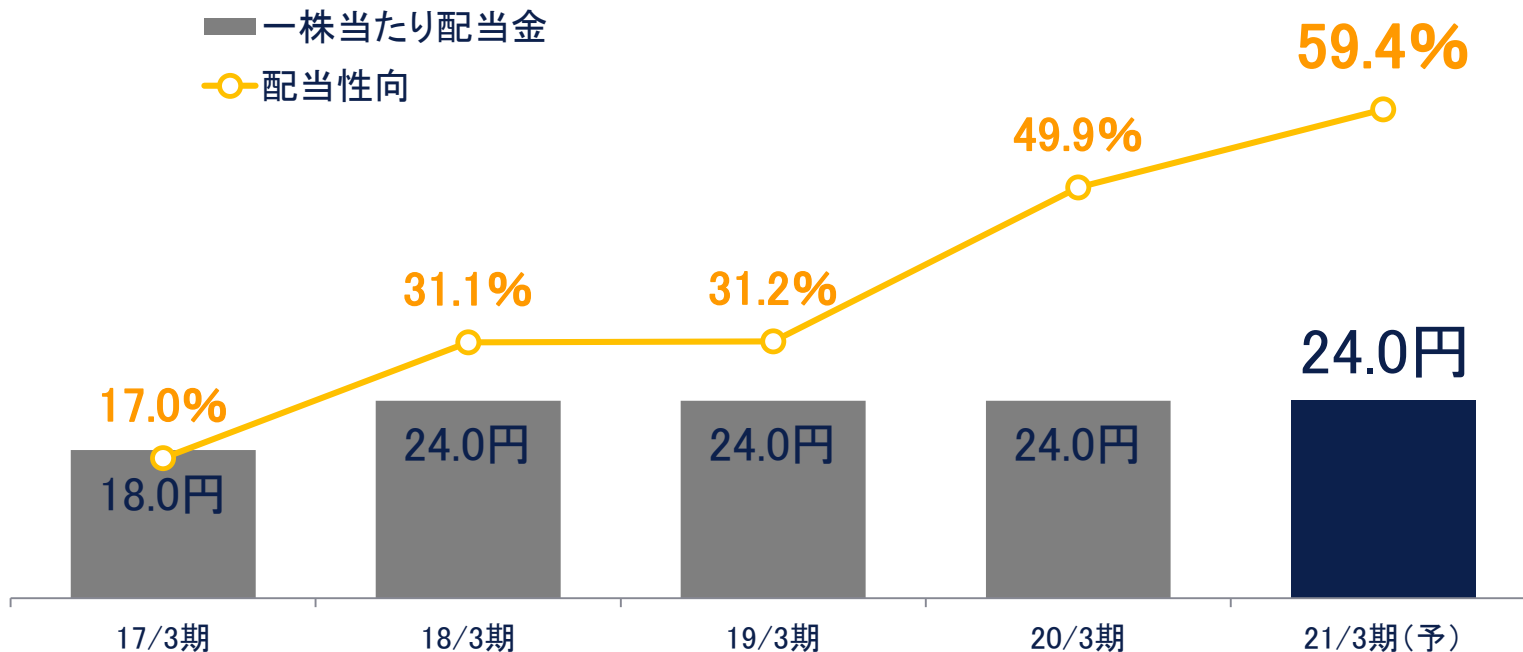
その他の産業向け

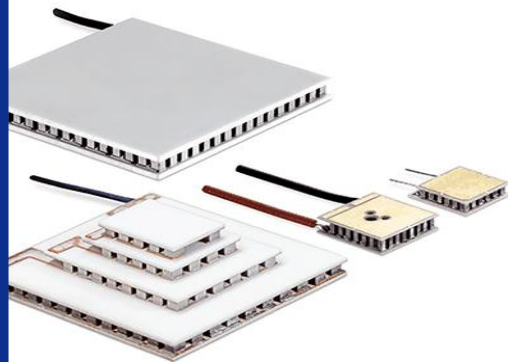
- ・通信機器向けは上期比では若干減収の見通し
- ・パワー基板は上期比でほぼ横ばいの需要見通し

《施策》

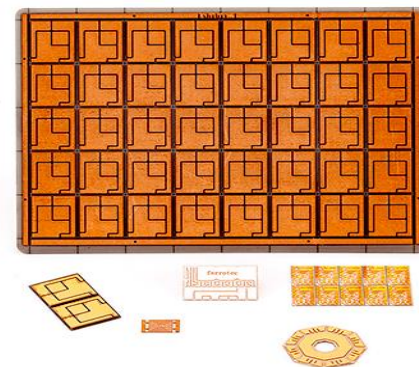
- ・サーモジュールのサブアッセンブリ品の世界的拡販活動を展開
- ・自動車向けアプリケーション開拓の更なる強化(量産化 3~5年)
- ・パワー基板は、自動車向け窒化ケイ素(AMB基板)の開拓強化

- 業績予想の非開示に伴い、配当予想は現時点では未定
- 安定配当を基本方針とし、業績向上に伴い増配を検討する





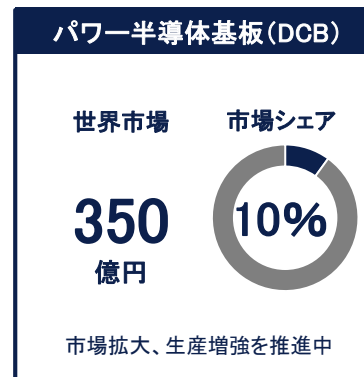
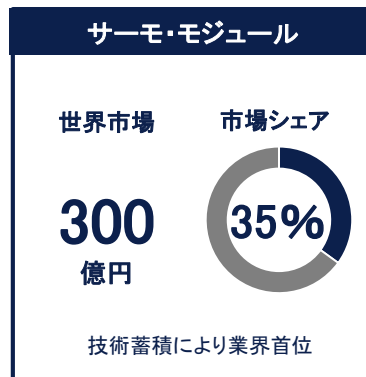
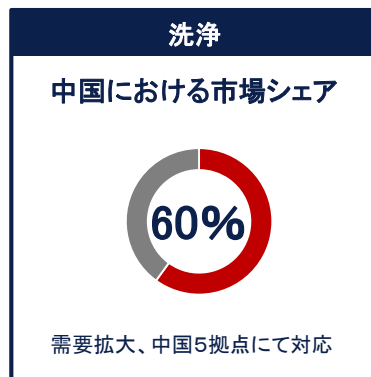
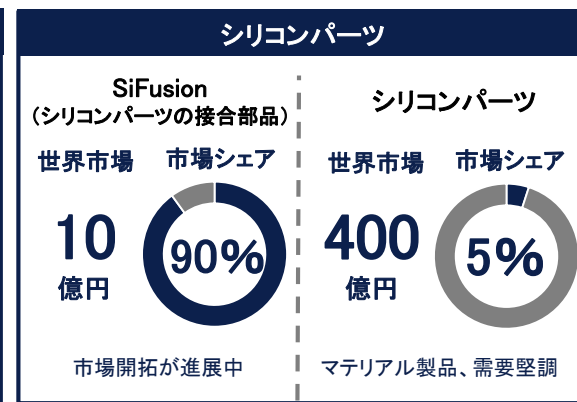
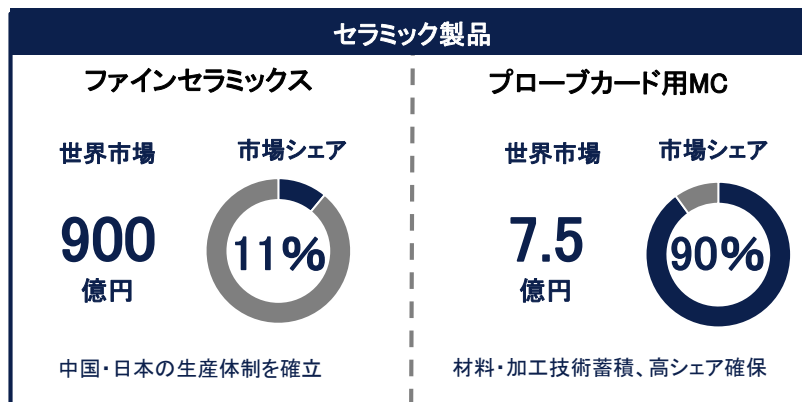
Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



Appendix



商号	株式会社フェローテックホールディングス 英語表記：Ferrotec Holdings Corporation
設立	1980年9月27日
本社	東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5F
上場	JASDAQスタンダード（証券コード：6890）
代表者	代表取締役社長 グループCEO 賀 賢漢
事業内容	グループ会社の経営管理、研究開発業務
資本金	17,664百万円
発行済株式数	37,251,702株(自己株式93,568株を含む)
関連会社	【連結子会社】46社 【持分法適用子会社】6社
従業員	【連結】7,775名 【単体】66名



業績比較(21/3期 上期 計画値と実績)

(百万円)	2021年3月期2Q 計画値		2021年3月期2Q 実績			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	28,140	70.3	28,784	69.2	645	2.3
真空シール	4,390	11.0	4,377	10.5	△ 13	△ 0.3
石英製品	9,210	23.0	9,122	21.9	△ 88	△ 1.0
セラミックス	5,380	13.4	5,682	13.7	302	5.6
CVD-SiC	1,080	2.7	1,143	2.7	63	5.8
EBガン・LED蒸着装置	1,460	3.6	1,450	3.5	△ 10	△ 0.7
ウェーハ加工	2,810	7.0	3,102	7.5	292	10.4
部品洗浄	3,380	8.4	3,459	8.3	79	2.3
石英坩堝	430	1.1	450	1.1	20	4.7
電 子 デ バ イ ス	6,770	16.9	7,116	17.1	346	5.1
サーモジュール	6,480	16.2	6,814	16.4	334	5.2
磁性流体・その他	290	0.7	302	0.7	12	4.1
そ の 他	5,090	12.7	5,693	13.7	603	11.8
合 計	40,000	100.0	41,595	100.0	1,594	4.0

売 上 総 利 益	13,320	33.3	14,098	33.9	778	5.8
販 売 管 理 費	10,320	25.8	10,185	24.5	△ 135	△ 1.3
営 業 利 益	3,000	7.5	3,913	9.4	913	30.4
経 常 利 益	2,500	6.2	2,824	6.8	324	13.0
四 半 期 純 利 益	0	-	70	0.2	70	-

業績比較(21/3期 上期実績と下期計画値)

(百万円)	2021年3月期2Q 実績		2021年3月期2Q下期 計画値			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	28,784	69.2	29,969	69.0	1,185	4.1
真空シール	4,377	10.5	3,695	8.5	△ 682	△ 15.6
石英製品	9,122	21.9	10,281	23.7	1,159	12.7
セラミックス	5,682	13.7	4,988	11.5	△ 694	△ 12.2
CVD-SiC	1,143	2.7	1,120	2.6	△ 23	△ 2.0
EBガン・LED蒸着装置	1,450	3.5	2,117	4.9	667	46.0
ウェーハ加工	3,102	7.5	3,343	7.7	241	7.8
部品洗浄	3,459	8.3	3,939	9.1	480	13.9
石英坩堝	450	1.1	487	1.1	37	8.2
電 子 デ バ イ ス	7,116	17.1	7,449	17.2	333	4.7
サーモジュール	6,814	16.4	6,981	16.1	167	2.4
磁性流体・その他	302	0.7	468	1.1	166	55.0
そ の 他	5,693	13.7	5,987	13.8	294	5.2
合 計	41,595	100.0	43,405	100.0	1,811	4.4

売 上 総 利 益	14,098	33.9	13,843	31.9	△ 255	△ 1.8
販 売 管 理 費	10,185	24.5	11,007	25.4	822	8.1
営 業 利 益	3,913	9.4	2,587	6.0	△ 1,326	△ 33.9
経 常 利 益	2,824	6.8	2,676	6.2	△ 148	△ 5.2
四 半 期 純 利 益	70	0.2	1,430	3.3	1,360	-

業績比較(20/3期と21/3期)

(百万円)	2020年3月期 実績		2021年3月期 計画			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	52,881	64.8	58,754	69.1	5,873	11.1
真空シール	8,136	10.0	8,072	9.5	△ 64	△ 0.8
石英製品	16,373	20.1	19,402	22.8	3,029	18.5
セラミックス	9,048	11.1	10,670	12.6	1,622	17.9
CVD-SiC	2,036	2.5	2,263	2.7	227	11.1
EBガン・LED蒸着装置	3,973	4.9	3,567	4.2	△ 406	△ 10.2
ウェーハ加工	6,754	8.3	6,445	7.6	△ 309	△ 4.6
部品洗浄	5,606	6.9	7,398	8.7	1,792	32.0
石英坩堝	955	1.2	937	1.1	△ 18	△ 1.9
電 子 デ バ イ ス	13,489	16.5	14,565	17.1	1,076	8.0
サーモモジュール	12,701	15.6	13,795	16.2	1,094	8.6
磁性流体・その他	789	1.0	770	0.9	△ 19	△ 2.4
そ の 他	15,243	18.7	11,681	13.7	△ 3,563	△ 23.4
合 計	81,614	100.0	85,000	100.0	3,386	4.1
売 上 総 利 益	26,928	33.0	27,942	32.9	1,014	3.8
販 売 管 理 費	20,915	25.6	21,192	24.9	277	1.3
営 業 利 益	6,013	7.4	6,500	7.6	487	8.1
経 常 利 益	4,264	5.2	5,500	6.5	1,236	29.0
当 期 純 利 益	1,785	2.2	1,500	1.8	△ 285	△ 16.0
設 備 投 資 額	33,920	41.6	29,400	34.6	△ 4,520	△ 13.3
減 価 償 却 費	7,600	9.3	10,000	11.8	2,400	31.6

- 本資料に掲載されている業績見通しの数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、新型コロナウイルス、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- 本資料中の2021年3月期の設備投資額は、あくまで今期の予算をベースに策定したものであり、確定したものではありません。また、当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

<照会先>

IR室 03-3281-8186